

项目代码：2510-440112-04-01-823561



防伪二维码

广东省企业投资项目备案证

申报企业名称：广州广芯封装基板有限公司

经济类型：其他

项目名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产
品制造项目厂房建设项目

建设地点：广州市黄埔区九龙镇知新路1321号

建设类别：☒ 基建 ☐ 技改 ☐ 其他

建设性质：☒ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 其他

建设规模及内容：

本项目建设地点位于广州黄埔区中新知识城，总投资3.8亿元，均为基建投资。项目将建设封装基板专业工厂厂房1栋以及配套建筑1栋，用于生产半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品。项目占地面积约26050平方米，总建筑面积约104200平方米。

项目总投资：38000.00 万元（折合 万美元） 项目资本金：38000.00 万元

其中：土建投资：38000.00 万元

设备及技术投资： 0.00 万元； 进口设备用汇： 0.00 万美元

计划开工时间：2025年11月

计划竣工时间：2027年12月

备案机关：开发区行政审批局

备案日期：2025年10月31日

更新日期：2025年11月07日

延期至：2027年11月07日

备注：

提示：1. 备案证明文件仅代表备案机关确认收到建设单位项目备案信息的证明，不具备行政许可效力。
2. 备案有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的，备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设的，备案证长期有效。

广东省发展和改革委员会监制